

<<微电子封装技术>>

图书基本信息

书名：<<微电子封装技术>>

13位ISBN编号：9787312014253

10位ISBN编号：7312014259

出版时间：2003-4

出版时间：中国科学技术大学出版社

作者：中国电子学会生产技术学分会丛书编委会 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<微电子封装技术>>

内容概要

本书比较全面、系统、深入地论述了在晶体管 and 集成电路（IC）发展的不同历史时期出现的典型微电子封装技术，着重论述了当前应用广泛的先进IC封装技术——QFP、BGA、FCB、MCM和3D封装技术，并指出了微电子封装技术今后的发展趋势。

全书共分8章，内容包括：绪论；芯片互连技术；插装元器件的封装技术；表面安装元器件的封装技术；BGA和CSP的封装技术；多芯片组件（MCM）；微电子封装的基板材料、介质材料、金属材料及基板制作技术；未来封装技术展望。

书后还附有微电子封装技术所涉及的有关缩略语的中英文对照等，以便读者查阅。

本书涉及的知识面广，又颇具实用性，适合于从事微电子封装研发、生产的科技人员及从事SMT的业界人士阅读，也是高校相关专业师生的一本有价值的参考书。

<<微电子封装技术>>

书籍目录

序前言第1章 绪论 1.1 概述 1.2 微电子封装技术的分级 1.3 微电子封装的功能 1.4 微电子封装技术发展的驱动力 1.5 微电子封装技术与当代电子信息技术第2章 芯片互连技术 2.1 概述 2.2 引线键合技术 2.3 载带自动焊技术 2.4 倒装焊技术 2.5 埋置芯片互连——后布线技术 2.6 芯片互连方法的比较第3章 插装元器件的封装技术 3.1 概述 3.2 插装元器件的分类与特点 3.3 主要插装元器件的封装技术第4章 表面安装元器件的封装技术 4.1 概述 4.2 SMD的分类及其特点 4.3 主要SMD的封装技术 4.4 塑料封装吸潮引起的可靠性问题第5章 BGA和CSP的封装技术 5.1 BGA的基本概念、特点和封装类型 5.2 BGA的封装技术 5.3 BGA的安装互连技术 5.4 CSP的封装技术 5.5 BGA与CSP的返修技术 5.6 BGA、CSP与其他封装技术的比较 5.7 BGA和CSP的可靠性 5.8 BGA和CSP的生产与应用第6章 多芯片组件.....第7章 微电子封装的基板材料、介质材料、金属材料及基板制作技术第8章 未来封装技术展望附录1 中英文缩略语附录2 常用度量衡主要参考文献

<<微电子封装技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>